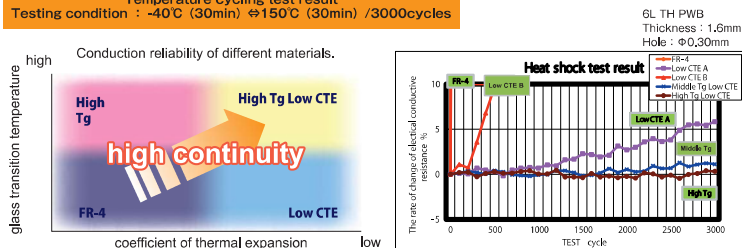


For High-Heat-resistance

基材のバリエーション Types of PCB materials

高耐熱環境へ対応するため、幅広い材料のスルーホール導通信頼性評価を行い、品質要求に応じた最適材料をご提案します。
Optimum materials for high-heat resistance can be proposed according to customer's requests based on our reliability test data of plated through holes in PCBs made with various types of materials.

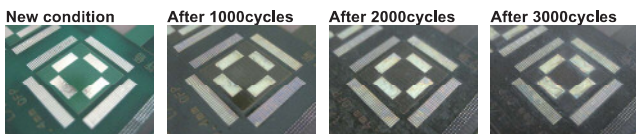
温度サイクル試験 高温側150℃条件における信頼性結果
Temperature cycling test result
Testing condition: -40℃ (30min) ⇄ 150℃ (30min) / 3000cycles



Tg150℃以上の材料が必要
Materials need to have Tg = 150℃ or more.

ソルダーレジストのバリエーション Types of Solder resist

高耐熱に対応したソルダーレジストをラインアップ
Possible to use Solder resist for High-heat resistance.
温度サイクル試験後においても高密度性を維持 (試験条件: -40℃⇄150℃ 各30min、はんだレベラー処理品)
Good adhesives can be kept after temperature cycling tests (test condition: -40℃⇄150℃ dwell time 30min., surface finish: solder leveling)



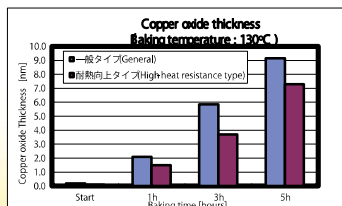
表面処理のバリエーション Types of Surface finish

耐熱向上タイプの水性ブリフラックスをラインアップ
Possible to use OSP of high-heat resistance type.

	耐熱性 heat resistance	平滑性 smoothness	環境 environment	コスト cost	生産対応 capability
水性ブリフラックス (一般タイプ) OSP (Normal type)	○	○	○	○	○
水性ブリフラックス (耐熱向上タイプ) OSP (high-heat resistance type)	○	○	○	○	○
無鉛はんだレベラー Lead-free solder leveler	○	×	○	×	×
Ni/Auめっき Ni-Au plating	○	○	○	×	○
Snめっき Sn plating	○	○	○	×	○

総合的に判断して水性ブリフラックス (耐熱向上タイプ) を推奨
OSP (High-heat resistance type) are recommended with our comprehensive way.

水性ブリフラックスの耐熱性比較
(Figure of comparing heat resistances of 2 OSPs)



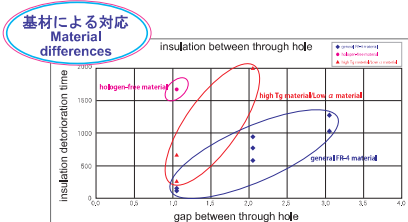
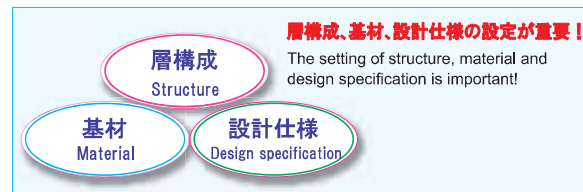
耐熱向上タイプは熱負荷による酸化を抑制
OSP high-heat resistance type decrease copper oxide growth.

For High voltage

環境対応車 (EV・HEV・PHEV) の普及によるパワーエレクトロニクス機器の出力向上と合わせてプリント配線板の「高電圧化」を実現します。

High power electronics units in various EV, HEV, PHEV request PCB for High voltage spec. Our PCB for High voltage can meet the spec.

PCB for high voltage



耐マイグレーション性に優れた材料 (ハロゲンフリー材) を推奨。
Materials (halogen-free) with anti-electrochemical migration are recommended.

**層構成による対応
Layer structure difference**

層間の絶縁層厚 (プリプレグ枚数) を増やすことで、絶縁性能を強化。
PCB insulation performance for high voltage can be improved by increasing insulation layer thickness (= the number of PP).

(一般層構成でのNG事例: 層間)
Failure example in general structure: Layer to layer

(Layer to layer: 0.2mm/ DC1kV)

**設計仕様による対応
Circuit-design difference**

要求特性 (高電圧への耐性) に応じて、十分な絶縁間隙を確保することが重要。当社では豊富な試験データと実績に基づき設計仕様を提案。
It is necessary for High voltage to change the insulation distance to adequate distance according to customer requested spec (high voltage spec).
Our circuit design spec can be proposed based on various test results and manufacturing experiences.

(一般材でのNG事例: TH間)
Failure example in general material: TH to TH

(TH to TH: 2.05mm/ DC1kV)

For High-heat radiation, High-current

『CMK-COMP シリーズ』にてプリント配線板の高放熱・大電流化を実現します。
Our PCBs called CMK-COMP series can have performances for High-heat radiation and High-current.

CMK-COMP シリーズ

銅ベース
Cu base

銅板にダイレクト放熱
Heat radiation directly to Cu board.

銅コア
Cu core

基板全体に熱拡散
Heat-spread to whole PCB.

内層厚銅
Inner circuit thick Cu

断面積拡大により大電流を許容
High-current can be allowed with thick Cu.



記載内容は予告なく変更する場合があります。
The contents are subject to change without notice.
2025.01